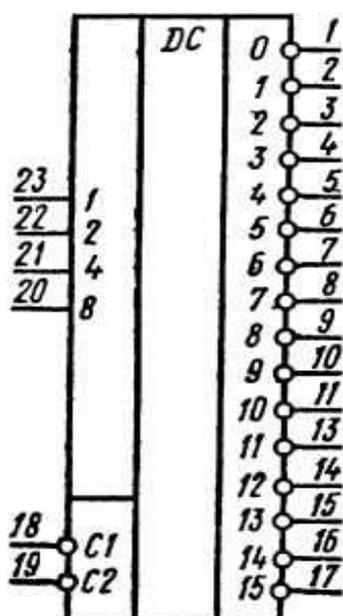


КР1533ИДЗ, КФ1533ИДЗ, ЭКФ1533ИДЗ

Микросхемы представляют собой дешифратор 4×16 . Если на одном из стробирующих входов устанавливается высокий уровень, то на всех 16 выходах также будет высокий уровень независимо от кода на входах D1...D4. Корпус типа 2142.24-2, масса не более 4 г, 4322.24-А.

Назначение выводов: 1 - выход $\overline{Y0}$; 2 - выход $\overline{Y1}$; 3 - выход $\overline{Y2}$; 4 - выход $\overline{Y3}$; 5 - выход $\overline{Y4}$; 6 - выход $\overline{Y5}$; 7 - выход $\overline{Y6}$; 8 - выход $\overline{Y7}$; 9 - выход $\overline{Y8}$; 10 - выход $\overline{Y9}$; 11 - выход $\overline{Y10}$; 12 - общий; 13 - выход $\overline{Y11}$; 14 - выход $\overline{Y12}$; 15 - выход $\overline{Y13}$; 16 - выход $\overline{Y14}$; 17 - выход $\overline{Y15}$; 18 - вход стробирования $\overline{C1}$; 19 - вход стробирования $\overline{C2}$; 20 - вход информационный D4; 21 - вход информационный D3; 22 - вход информационный D2; 23 - вход информационный D1; 24 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИДЗ, КФ1533ИДЗ, ЭКФ1533ИДЗ

Электрические параметры

| | |
|---|------------------|
| Номинальное напряжение питания | 5 В \pm 10% |
| Выходное напряжение низкого уровня при $U_n = 4,5$ В | $\leq 0,4$ В |
| Выходное напряжение высокого уровня при $U_n = 4,5$ В | $\geq 2,5$ В |
| Входной ток низкого уровня | $\leq -0,2 $ мА |
| Входной ток высокого уровня (для одиночного входа) | ≤ 20 мкА |
| Ток потребления при $U_n = 5,5$ В | ≤ 15 мА |
| Время задержки распространения сигнала при включении: | |
| - от входов 20, 21, 22, 23 к выходам | ≤ 33 нс |
| - от входов 18, 19 к выходам | ≤ 32 нс |

Время задержки распространения сигнала при выключении:

- от входов 20, 21, 22, 23 к выходам ≤ 36 нс
- от входов 18, 19 к выходам ≤ 30 нс

Емкость входа ≤ 5 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания 4,5...5,5 В

Входное напряжение низкого уровня 0...0,8 В

Входное напряжение высокого уровня 2...5,5 В

Максимальное напряжение, подаваемое на выход 5,5 В

Температура окружающей среды -10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в

пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.